

证券代码：301338

证券简称：凯格精机

东莞市凯格精机股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-001

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 电话/网络会议
参与单位名称及人员姓名	中泰证券、长城财富保险、东吴基金、海富通基金、汇安基金、惠通基金、中银基金、金鹰基金、景顺长城、中加基金、中信保诚、国融基金、朴信投资等 17 位投资者。
时间	2024 年 04 月 23 日 16:00-17:00
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事长 邱国良 总经理 刘小宁 财务总监 宋开屏 董事会秘书 邱靖琳
投资者关系活动主要内容介绍	公司基本情况介绍： 董秘邱靖琳女士详细介绍了公司 2023 年度主营业务情况。 2023 年度，公司实现营业收入 74,002.14 万元，同比下降 5.04%；公司实现归属于上市公司股东的净利润为 5,257.71 万元，同比下降 58.63%。 营业收入同比小幅下降，但营收结构变化较大。变化主要为作为细分领域单项冠军的锡膏印刷设备实现营业收入 40,161.97 万元，同比下降 31.88%，营收占比为 54.27%，同

比下降 21.38 个百分点；封装设备实现营业收入 21,634.21 万元，营收占比为 29.23%，同比增长 263.95%，同比上升 21.6 个百分点。

公司净利润同比下降较多，主要原因系锡膏印刷设备营业收入下降较多及毛利率小幅下降，对公司的净利润影响较大；封装设备营业收入增长较多，但毛利率较低，对公司净利润贡献较小。

公司与参会人员就以下问题进行了探讨：

### **1、封装设备板块爆发式增长的原因？**

答：公司封装设备下游以 LED 照明、显示为主，中游 LED 封装企业具有降本增效和产能升级的需要，通过替换和新增设备，实现效率提升和产能升级。公司 LED 封装设备经过多年的技术沉淀，面对芯片小型化趋势显现出的设备效率和稳定性优势获得 LED 封装头部企业的高度认可，产品营业收入同步增长 263.95%。

在传统 LED 固晶机出货量取得突破之后，继续推进产品优化及供应链降本增效，扩大交付边际效应，提升产品毛利率；充分发挥公司固晶机在芯片小型化趋势上设备效率及稳定性的竞争优势，加大力度拓展 Mini/Micro LED 固晶机客户，提升市场占有率。

### **2、针对于产品毛利率下滑，公司采取了哪些措施？**

答：公司产品毛利率下降主要有两方面的原因，一方面是客户的降本压力传导给企业，导致价格小幅下降；另一方面是，封装设备在大客户开发过程中，为突破行业竞争格局，提升产品市场占有率和规模化效应，公司在价格方面做了一些让

步，从而取得了收入的重大突破。公司将继续优化产品，迭代升级产品性能，保持产品市场地位和竞争力，同时通过技术创新、供应链的管理和市场细分领域的深耕以期提高产品毛利率。

### **3、 公司认为下游有回暖的趋势吗？**

答：尽管面临诸多挑战，电子行业在 2023 年的第四季度展现出回暖的迹象，根据行业数据显示，智能手机和 PC 等消费电子产品在经历了长时间的销量下滑之后，2023 年第四季度出货量出现边际改善迹象，叠加具备更强 AI 能力的智能手机以及 AIPC 的推出，消费电子行业景气度有所改善。从公司锡膏印刷设备出货量的角度来看，2023 年第四季度同比实现一定增长。

### **4、 公司海外布局的情况是怎么样的？**

答：公司的海外策略是一个多方位、多层次的国际化布局，旨在通过跟随现有客户、深化海外子公司的本地化运营、灵活应对市场变化以及积极参与国际交流，来实现全球市场的持续增长和品牌影响力的提升。

### **5、 能否简要介绍公司的研发布局**

答：一直以来，公司坚持“好的产品是设计出来的”研发理念，坚定落实公司“共享技术平台+多产品+多领域”的研发布局，实现公司产品从单个“单项冠军”迈向多个“单项冠军”的战略。落实公司战略布局，将各个事业部的产品方向从 SMT 向泛半导体 COB 及半导体封装领域衍生。比如，公司面向半导体行业推出 Climber 系列产品；锡膏印刷设备- PLED-mini 可满足 COB Mini LED 的印刷要求；Gsemi 植球

设备可满足半导体封装领域晶圆植球的要求；点胶设备-D-semi 可满足半导体领域点胶点锡、底部填充、BGA 焊球强化工艺要求。

#### **6、公司锡膏印刷设备的竞争力如何？**

答：公司的锡膏印刷设备技术能力处于国内领先、国际先进水平。公司锡膏印刷设备可较好地解决印刷过程中面临的复杂问题，为客户提供一整套锡膏印刷解决方案。

锡膏印刷设备对于整个 SMT 产线的重要性很高，电子产品 SMT 组装过程中大概 60-70%的焊接缺陷是由于锡膏印刷不良引起的，所以下游大客户会非常谨慎地选择锡膏印刷设备的供应商。

#### **7、公司未来展望如何？**

答：2024 年是凯格精机产品深化布局的攻坚年，我们会在之前的基础上继续深化产品布局。

首先，巩固单项冠军锡膏印刷设备的市场领导地位，持续优化产品，推进产品迭代升级，继续保持产品品质、工艺方案及技术支持等多方面的竞争优势。

其次，在传统 LED 固晶机出货量取得突破之后，继续推进产品优化及供应链降本增效，扩大交付边际效应，提升产品毛利率；充分发挥公司固晶机在芯片小型化趋势上设备效率及稳定性的竞争优势，加大力度拓展 Mini/Micro LED 固晶机客户，提升市场占有率。

最后，增加应用于泛半导体及半导体产品的资源投入，积极引进行业专业人才提高产品性能，提升新产品的开发能力和渠道拓展能力。通过公司国内外资源，获得与潜在客户技术

	对接的机会，增加产品供应品类。
附件清单（如有）	无
日期	2024年4月23日